# Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

# Produktbeschreibung

LED-Platine Leiterplatte Leiterplatte in China pcb hersteller in china

#### **Schnelle Details**

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Leading
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupferdicke	0,5 oz-5 oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenveredelung	Immersionsgold, OSP, bleifreies HASL	Brettstärke	0,1-5 mm
anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerungsplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg bis 5 kg	MOQ	10 stück
Farbe blau, rot, grün, schwarz		Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Modell-Nr	pcba-hersteller von energienbanken	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01m3-10m3

#### Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen: 16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller		
Lieferung Detail:	7-12days	

### Produktbeschreibung

Antilcol	2014	2015 ~ 2016	2017 ~ 2018	
Artikel	Volumen Probe	Volumen Probe	Volumen Probe	

Schichtanzahl	32	42	38	44	42	48
Min Line / Abstand (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
von PIH						20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Beliebige Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung über	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kernstärke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrer Durchmesser (μm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt via	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Embedded-Kondensator-PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersionssilber, Immersionsdose, Flash-Gold, Vergoldung mit Finger, Selektive Hartvergoldung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte					

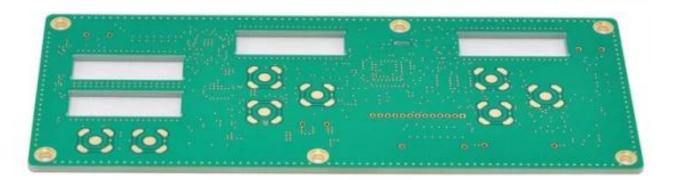












www.o-leading.com

**Unser Team** 





Zertifizierungen





#### QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

#### We hereby certify that O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO., LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-17-2 Registration Act ROOM 6030.6F HANG PONT COMMERCIAL BULDING,31 TONKIN ST,CHEUNG SHA WAN,KI,HK Business Act 1313 Floor 13 Forture Building,Danstru Town,Huyang District, Huchou, Guangdong,Chris

Has implemented and maintains a Quality Management System

Which fulfils the requirements of the following standards GB/T19001-2016 ldt ISO9001:2015

### Scope of certification

Sales of printed circuit boards

mark

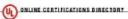
Initial Issuance period: February 27, 2018 This certificate is valid during: February 27, 2018 — February 26, 2021 This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First	0.000	Second	
supervision	Qualified	supervision	Q:
and audit	man	and audit	

CICC TAB CNAS

2017/26

ZPWVZE40054 - Wining, Phinto: - Component.



### ZPMV2.E490354 Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit  $0.1\times 10^{-6}$  Family of Databases. Citix on a product designation for complete information.

#### Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED

E490354

Fortune Building, Nanhang West Road Room 131,3 Huithou, Guangdons 516211 CHINA

1	Cond	Width	1		Max	. 9		Max		9	
		Min	Cond	SS/	Aren	Sol	der	Oper		Nests	4
1.5	Min	Edge	This	DS/	Diam	Lin	ette	Tump	Flame	UL796	,
Турс	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	090	me(in)	c	sec	e	Class	DSR	ī
Hulti	ayer (mass lan	ninate) printed	wiring boa	erds.						(i - )	7
O-LE	ADING-401										Т
1 13	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DE	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0		ŀ
0-15	ADING-407										
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0-67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All .	F
Hulti	ayer printed w	iring boards.									_
0-LE	ADING-408	6								-0. 0	3
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:138	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	1
Single	e layer printed	wiring boards.									
O-LE	DING-002	0			33 11					3 0	ī
	0.78 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1,34)	55	(9.1 (0.0)	260	10	105	V-0	M	ŀ
0-12	ADING-003				3 8						1
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1,34)	55	19.1 (0.8)	260	10	130	940	<b>A</b>	ŀ
0-15	ADING-033		3								
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	55	25.4 (1.0)	260	10	120	940	41	ŀ
O-LE	ADING-205		3								
	0.1 [0.004]	0.5 (0.012)	34 (1.34)	DE	69.6 (2.7)	250	10	130	V+0	All .	-
O-LE	ADING-206		500	63.			- 53				
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0-67)	DS.	69-6 (2-7)	260	10	130	V-0	All .	-

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Nording: Company name or file number and type designation. Nay be followed by a suffix to desoite factory identification or burning text desoitedation. Last ligitated on 2017-91-27

Questions? Print this gage Terms of Use rapidatase Journa (BAYVInglandSEKT/ERVINELLogoga) milkare ZEMVZ, Edition Landaudi Villing (Printe) +Corporation (- 12 SGS

Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

scimen No. SGS Sample ID Description SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% (2) MDL = Method Detection Limit (3) ND = Not Detected ( < MDL) (4) "-" = Not Regulated

#### RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7:22017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-6:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Rem(s)	Limit	Unit	MOL	001
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	NO
Lead (Pb)	1.000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1.000	mg/kg	2	NO
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	. 6	NO
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	14	NO
Manabromobiphenyl		mg/kg	5	NO
Dibromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	4	mg/kg	5	NO
Tetrabromobiphenyl		mg/kg	. 5	NO
Pentatromotiphenyl		mg/kg	5	NO
Hexabromobiphenyl		mg/kg	5	NO:
Heptabromobiphenyl		mg/kg	- 5	NO
Octabromobiphenyl		mg/kg	5	NO
Nonabromobiphenyl		mg/kg	5	NO
Decabromobiphenyl	7700	mg/kg		ND
Sum of PBDEs	1.000	mg/kg	12	NO
Manabromodipheryl ether		mg/kg	5	NO
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	NO
Tribromodiphenyl ether	4	mg/kg	5	NO
Tetrabromodiphenyl ether		mg/kg	5	NO
Pentahromodioheral ether		mafea		MO



# Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days



## **FAQ**

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

- 1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
- 2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
- 3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
- 4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
- 5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

#### 2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide

Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

- 3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden? Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium-/ Kupferbasis, PI usw.
- 4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt? Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.
- 5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten? Materialschneiden  $\rightarrow$  Innerer Trockenfilm  $\rightarrow$  Inneres Ätzen  $\rightarrow$  Inneres AOI  $\rightarrow$  Multi-Bond  $\rightarrow$  Schichtstapel Pressen  $\rightarrow$  Bohren  $\rightarrow$  PTH  $\rightarrow$  Plattieren  $\rightarrow$  Äußerer Trockenfilm  $\rightarrow$  Musterplattieren  $\rightarrow$  Äußeres Ätzen  $\rightarrow$  Äußeres AOI  $\rightarrow$  Lötmaske  $\rightarrow$  Bauteilmarkierung  $\rightarrow$  Oberflächenfinish  $\rightarrow$  Routing  $\rightarrow$  E / T  $\rightarrow$  Sichtprüfung.